molex

PRODUCT SPECIFICATION

LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

【1. 適用範囲 SCOPE】

本仕様書は、＿＿＿＿＿＿＿＿殿　に納入する

＿0.35 mm ピッチ 基板対基板用 コネクタ＿について規定する。

This specification covers the 0.35mm PITCH BOARD TO BOARD CONNECTOR series

【2. 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND PART NUMBER】

製　品　名　称 Product Name	製　品　型　番 Part Number
リセプタクル　ハウジング　アッセンブリ Receptacle Housing Assembly	505066-**09
505066-**09　エンボス梱包品 Embossed Tape Package For 505066-**09	505066-**10/-**20
プラグ　ハウジング　アッセンブリ Plug Housing Assembly	505070-**19
505070-**19　エンボス梱包品 Embossed Tape Package For 505070-**19	505070-**20

REV.	G			
SHEET	1-16			

REVISE ON PC ONLY		TITLE: 0.35 BB CONN. H=0.6　SSB6 RP (Hgt=0.6mm)			
G	REVISED J2016-0369 '15/10/13 TSOMEYA	CONFIDENTIAL			
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DESIGN CONTROL J	STATUS	WRITTEN BY: T.SOMEYA	CHECKED BY: K.TANAKA03	APPROVED BY: K.MORIKAWA	DATE: YR/MO/DAY 2015/01/27

DOCUMENT NUMBER **PS-505066-003**		FILE NAME PS-505066-003.docx	SHEET 1 OF 16

【3. 定　格　RATINGS 】

項　　目 Item	規　　格 Standard	
最大許容電圧 Rated Voltage (MAX.)	50 V	[AC (実効値 rms) / DC]
最大許容電流 Rated Current (MAX.)	Terminal 0.3 A / PIN*1 Fitting nail 3.0 A / PIN	
使用温度範囲*2 Operating Temperature Range*2	-40°C ～+85°C *3	
保管条件 Storage Condition	温度 Temperature	-10°C～+50°C
	湿度 Humidity	85%R.H.以下（但し結露しないこと） 85%R.H. MAX. (No Condensation)
	期間 Terms	出荷後6ヶ月（未開封の場合） For 6 months after shipping (unopened package)

*1：最大許容電流0.3Aでの使用は最大50極までとする。
但し、50極以上の総電流は各極を合計し、15A以下で使用すること。
0.3A MAX./PIN is to applied to 50pins MAX.
A total of 15A MAX. is to be applied to over 50 pins.
*2：基板実装後の無通電状態は、使用温度範囲が適用されます。
Non-operating connectors after reflow must follow the operating temperature range condition.
*3：通電による温度上昇分を含む。
This includes the terminal temperature rise generated by conducting electricity.

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

【4. 性　能　PERFORMANCE】

標準状態；特に指定がない限り、測定は温度 15～35℃、湿度 25～85%、気圧 86～106kPa にて行う。但し、
判定に疑義を生じた場合は、温度 20±1℃、湿度 63～67%、気圧86～106kPa にて行う。

Standard atmospheric conditions;
Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions for making measurements and tests are as follows.
Ambient temperature : 15℃ to 35℃
Relative humidity : 25% to 85%
Air pressure : 86kPa to 106kPa
If there is any doubt about the results, measurements shall be made by the following test conditions.
Ambient temperature : 20±1℃
Relative humidity : 63% to 67%
Air pressure : 86kPa to 106kPa

4-1. 電気的性能 Electrical Performance

項　目 Item		条　件 Test Condition	規　格 Requirement	
4-1-1	接 触 抵 抗 Contact Resistance	コネクタを嵌合させ、開放電圧 20mV 以下、短絡電流 10mA以下 にて測定する。(JIS C5402 5.4) Mate connectors, measured by dry circuit, 20mV MAX., 10mA MAX. (JIS C5402 5.4)	For Terminal : 80 milliohm MAX. For Nail : 30 milliohm MAX.	
4-1-2	絶 縁 抵 抗 Insulation Resistance	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間に DC 250V を印加し測定する。(JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 試験法 302) Mate connectors, apply 250V DC between adjacent terminal. (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 Method 302)	100 Megohm MIN.	
4-1-3	耐 電 圧 Dielectric Strength	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間に AC(rms) 250V (実効値) を 1分間 印加する。(JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 試験法 301) Mate connectors, apply 250V AC(rms) for 1 minute between adjacent terminal. (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 Method 301)	製品機能を損なう異状なきこと No Damage on function	
4-1-4	温 度 上 昇 Temperature Rise	コネクタを嵌合させ、最大許容電流を通電し、コネクタの温度上昇分を測定する。(UL 498) Connectors shall be mated and measure the temperature rise of contact, when the maximum AC Rated current is flowed. (UL 498)	温 度 上 昇 Temperature Rise	30 ℃ maximum

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

4-2. 機械的性能　Mechanical Performance

項　目 Item		条　件 Test Condition	規　格 Requirement
4-2-1	挿入力及び抜去力 Insertion and Withdrawal Force	1分間 5回以下 の速さで挿入、抜去を行う。 Insert and withdraw connectors at the speed rate of 5 cycles per minute.	第６項参照 Refer to paragraph 6
4-2-2	ターミナル保持力 Terminal / Housing Retention Force	ハウジングに装着されたターミナルを 毎分 25±3mm の速さで引張る。 Apply axial pull out force at the speed rate of 25±3mm/minute on the terminal pin assembled in the housing.	0.15N {0.015 kgf} minimum

4-3. 耐久性能　Durability Performances

項　目 Item		条　件 Test Condition	規　格 Requirement	
4-3-1	繰返し挿抜 Repeated Insertion / Withdrawal	1分間 5回以下 の速さで挿入、抜去を 30回 繰返す。 When mated up to 30 cycles repeatedly by the rate of 5 cycles per minute.	接 触 抵 抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.
4-3-2	耐 振 動 性 Vibration	DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な 3方向 に掃引割合 10～55～10 Hz/分、全振幅 1.5mm の振動を 各2時間 加える。 (MIL-STD-202 試験法 201) Amplitude : 1.5mm P-P Sweep time : 10~55~10 Hz in 1 minute Duration : 2 hours in each X.Y.Z. axes (MIL-STD-202 Method 201)	外　観 Appearance	製品機能を損なう異状なきこと No Damage on function
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.
			瞬　断 Discontinuity	1.0 microsec. MAX.

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

4-3-3	耐 衝 撃 性 Shock	DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な 6方向 に 490m/s² { 50G } の衝撃を 各3回 加える。 (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 試験法 213) 490m/s² { 50G }, 3 strokes in each X.Y.Z. axes. (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 Method 213)	外 観 Appearance	製品機能を損なう異状なきこと No Damage on function
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.
			瞬 断 Discontinuity	1.0 microsec. MAX.
4-3-4	耐 熱 性 Heat Resistance	コネクタを嵌合させ、85±2°C の雰囲気中に 96時間 放置後取り出し、1～2時間 室温に放置する。 (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 試験法 108) 85±2°C, 96 hours (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 Method 108)	外 観 Appearance	製品機能を損なう異状なきこと No Damage on function
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.
4-3-5	耐 寒 性 Cold Resistance	コネクタを嵌合させ、–40±3°C の雰囲気中に 96時間 放置後取り出し、1～2時間 室温に放置する。 (JIS C60068-2-1) –40±3°C, 96 hours (JIS C60068-2-1)	外 観 Appearance	製品機能を損なう異状なきこと No Damage on function
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

4-3-6	耐 湿 性 Humidity	コネクタを嵌合させ、60±2°C、 相対湿度 90～95% の雰囲気中に 96時間 放置後取り出し、1～2時間 室温に放置する。 (JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 試 験 法 103) Temperature : 60±2°C Relative Humidity : 90~95% Duration : 96 hours (JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 Method 103)	外 観 Appearance	製品機能を損なう 異状なきこと No Damage on function
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.
			耐 電 圧 Dielectric Strength	4-1-3項 満足のこと Must meet 4-1-3
			絶 縁 抵 抗 Insulation Resistance	50 Megohm MIN.
4-3-7	温度サイクル Temperature Cycling	コネクタを嵌合させ、 –55°C に 30分、 +85°C に 30分 これを 1サイクル とし、 5サイクル 繰返す。 但し、温度移行時間は 5分以内 とする。 試験後 1～2時間 室温に放置する。 (JIS C0025) 5 cycles of : a) – 55°C 30 minutes b) + 85°C 30 minutes (JIS C0025)	外 観 Appearance	製品機能を損なう 異状なきこと No Damage on function
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.
4-3-8	塩 水 噴 霧 Salt Spray	コネクタを嵌合させ、35±2°C にて 5±1% 重量比 の塩水を 48±4時間 噴霧し、試験後常温で水洗いした後、 室温で乾燥させる。 (JIS C60068-2-11/MIL-STD-202 試験法 101) 48±4 hours exposure to a salt spray from the 5±1% solution at 35±2°C. (JIS C60068-2-11/MIL-STD-202 Method 101)	外 観 Appearance	製品機能を損なう 異状なきこと No Damage on function
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

4-3-9	亜硫酸ガス SO_2 Gas	コネクタを嵌合させ、40±2°C にて50±5ppm の亜硫酸ガス中に 24時間 放置する。 24 hours exposure to 50±5ppm. SO_2 gas at 40±2°C.	外　観 Appearance	製品機能を損なう異状なきこと No Damage on function
			接触抵抗 Contact Resistance	For Terminal : 100 milliohm MAX. For Nail : 40 milliohm MAX.
4-3-10	半田付け性 Solderability	ターミナルまたはピンをフラックスに浸し、245±5℃ の半田に 3±0.5秒 浸す。 Soldering Time : 3±0.5 sec. Solder Temperature : 245±5℃	濡れ性 Solder Wetting	浸漬した金めっき面積の 95% 以上 95% of immersed gold plating area must show no voids, no pin holes.
4-3-11	半田耐熱性 Resistance to Soldering Heat	(リフロー時) 第7項の条件にて、2回リフローを行う。 (When reflowing) Expose the specimen to infrared reflow condition the test item paragraph 7 two times	外　観 Appearance	製品機能を損なう異状なきこと No Damage on function
		(手半田) 端子先端より0.2mm、金具先端より0.2mmの 位置まで350±10℃の半田ｺﾞﾃにて最大5秒加熱する。 (Soldering iron method) Solder time : 5 seconds MAX. Solder temperature : 350±10℃ 0.2mm from terminal tip fitting nail tip.		

( ) :参考規格　Reference Standard

{ } :参考単位　Reference Unit

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

【5. 外観形状、寸法及び材質　PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS】
図面参照　Refer to the drawing.
ELV 及び RoHS適合品　ELV AND RoHS COMPLIANT.
【6. 挿入力及び抜去力　INSERTION/WITHDRAWAL FORCE】

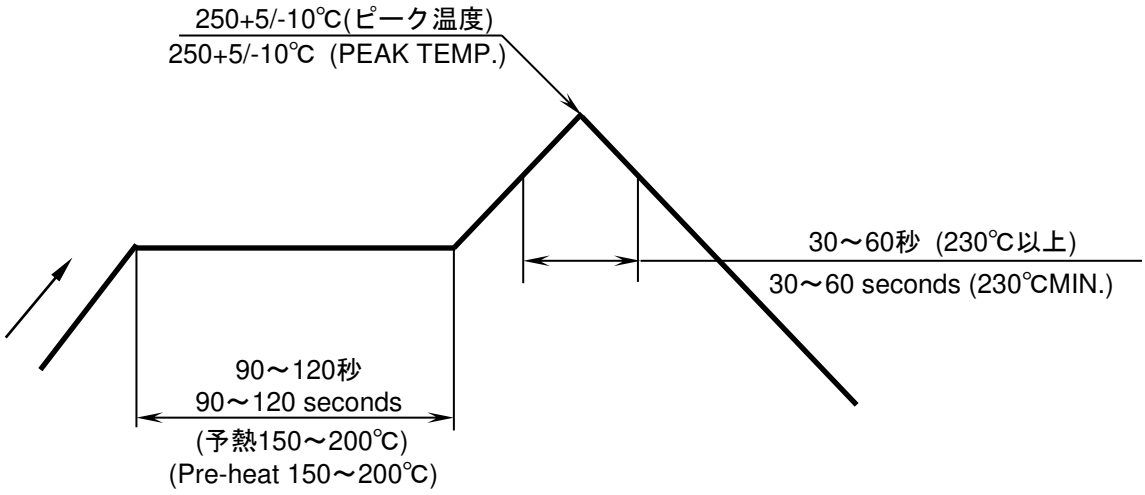
極 数 No. of CKT	単位 UNIT	挿入力（最大値） Insertion (MAX.)			抜去力（最小値） Withdrawal (MIN.)		
		初回 1st	６回目 6th	３０回目 30th	初回 1st	６回目 6th	３０回目 30th
6	N {kgf}	25.0 {2.55}			1.9 {0.19}		
12	N {kgf}	38.0 {3.87}			2.1 {0.22}		
14	N {kgf}	42.5 {4.33}			2.4 {0.24}		
16	N {kgf}	46.5 {4.74}			2.5 {0.26}		
20	N {kgf}	48.0 {4.90}			2.8 {0.29}		
22	N {kgf}	48.6 {4.96}			2.9 {0.30}		
24	N {kgf}	49.5 {5.05}			3.0 {0.31}		
30	N {kgf}	51.5 {5.25}			3.5 {0.35}		
34	N {kgf}	53.0 {5.41}			3.7 {0.38}		
40	N {kgf}	55.0 {5.61}			4.1 {0.42}		
48	N {kgf}	57.5 {5.86}			4.7 {0.48}		
50	N {kgf}	58.5 {5.96}			4.9 {0.49}		
54	N {kgf}	60.0 {6.12}			5.0 {0.51}		

(　　) :参考規格　Reference　Standard

{　　} :参考単位　Reference　Unit

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

【7．赤外線リフロー条件　INFRARED REFLOW CONDITION】



温度条件グラフ
TEMPERATURE CONDITION GRAPH
(基板表面温度)
(TEMPERATURE ON BOARD PATTERN SIDE)

注記：本リフロー条件に関しては、リフロー装置及び基板などにより条件が異なりますので
事前に実装評価（リフロー評価）の御確認を御願い致します。
また窒素雰囲気でリフロー（N2リフロー）する場合にも、半田量や実装条件の
ご確認をお願いいたします。

・推奨ランド寸法　Recommended Pattern dimension
SDをご参照下さい。Refer to the Sales Drawing.

・推奨メタルマスク厚さ Recommended Thickness of metal mask

t = 0.08 mm

・推奨メタルマスク開口率 Recommended Open aperture ratio of metal mask
80%　　(大気リフロー時 for atmosphere)
50 ～ 80%　(N2リフロー時 for Nitrogen atmosphere)

NOTE : Please check the mount condition (reflow soldering condition) by your own devices beforehand, because the condition changes by the soldering devices, P.W.Board, and so on.
Also please check mount condition in case of Nitrogen atmosphere.

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

【８．取り扱い上の注意事項　INSTRUCTION UPON USAGE】

[嵌合- Mating]

嵌合は極力嵌合軸に沿って平行に行って下さい。（図－１）
その際、リセハウジングとプラグの外壁同士を合せる様に位置決めした後に押し込み嵌合して下さい。
斜めの嵌合になる場合は10°以下の角度でリセハウジングとプラグの外壁同士を軽く当て、位置決めした後に嵌合して下さい。（図－２）
尚、コネクタ同士を過度に傾けた状態で嵌合を行いますと、ハウジングが破壊する恐れが有りますのでこのような嵌合はお避け下さい。（図－３）

Please mate the connector with parallel manner.　(Figure-1)
Please locate the inside wall of rec. housing and plug before mating.
In the case of skew mating, please do not mate the connector at more than 10° lead in angle .　(Figure-2)
Please do not mate connector at an angle as this manner, because the housing might be broken. (Figure-3)

[抜去- Un-mating]

抜去は極力嵌合軸に沿って平行に行って下さい。（図－１）
または、左右に少しづつ振りながら行って下さい。（図－４）
過度のこじり抜去には注意して下さい。
過度のこじり抜去ではコネクタが破壊する可能性があります。（図－５）

Please extract the connector with parallel manner (Figure-1),
or swing them right to left slightly.　(Figure-4)
Please be very careful when extracting the connector at an angle.
This may cause damage to the connector.　(Figure-5)

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

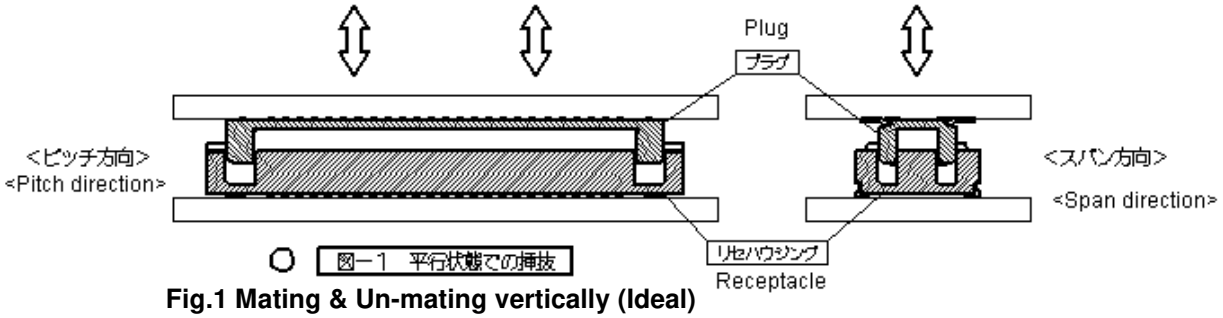


Fig.1 Mating & Un-mating vertically (Ideal)

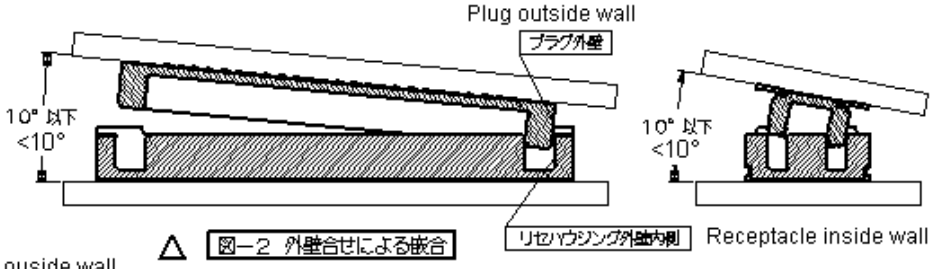


Fig.2 Mating with aligning plug outside to receptacle inside

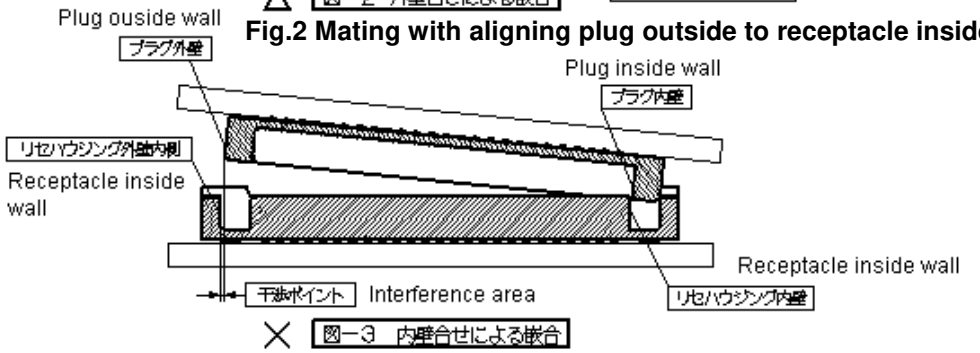


Fig.3 Mating with aligning plug inside wall to receptacle inside wall (Not preferred)

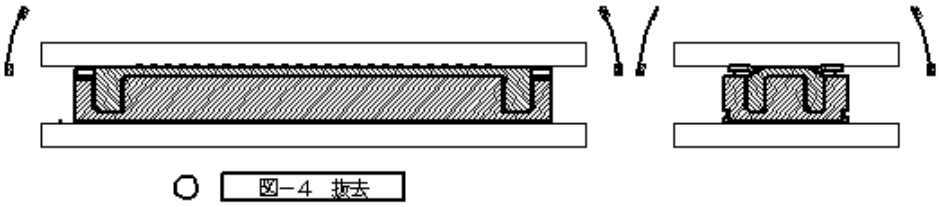


Fig.4 Un-mating by shaking back and forth

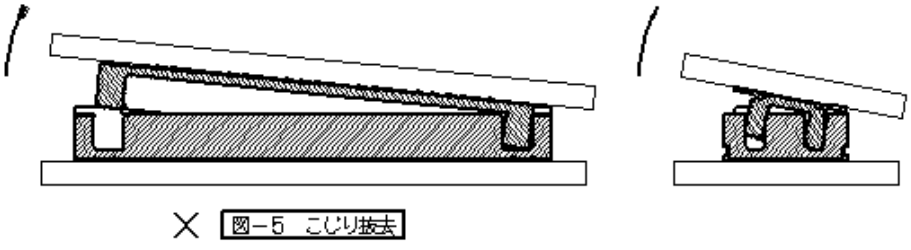


Fig.5 Un-mating with one strong rotation (can damage connector)

【９．その他　注意事項　OTHERS】

1. 基板実装前に端子周辺の成形品に過度の荷重を掛けないで下さい。
   Prohibit from applying an excessive load to the housing around terminals before mounting on P.W. Board.

2. 基板実装前後に端子、補強金具に触らないでください。
   Please do not touch the terminals and fitting nails before ot after reflowing the connector onto P.W. Board.

3. 成形品の色相に多少の違いを生じる場合がありますが、製品性能には影響ありません。
   There may be slight differences in the housing coloring, but there will be no influence on the product's performance.

4. モールド樹脂上に黒点、多少の傷、微小な気泡等が生じることが有りますが性能上問題有りません。
   本製品のモールド材料はLCPを使用しているため、ウエルドラインが目立つ場合がありますが、
   製品性能には、影響ないものです。
   Specification is met although black spots, scratch on the housing, or a minim air bubble and so on may exist on mold resin. As LCP is used as the mold material, the weld lines may be visible in some cases. However, they do not affect product performance.

5. 嵌合の際、嵌合が不十分にならないようにご注意下さい。また、セットへの組み込み後も、
   振動、衝撃等で嵌合の浮きが発生しないような状態にて使用してください。嵌合が浮き、
   基板同士あるいは基板とFPCが5度以上傾くと嵌合が抜ける可能性があります。
   Please ensure that the connector is fully mated. After setting the connector and cable assembly in the device, please ensure that the connector does not become unengaged due to vibration and shock conditions. There may be case of coming off if mating is insufficient and connectors get a inclines of 5 degrees .

6. 実装時は位置決めマーク（フィデューシャルマーク）等を設け、実装ずれに注意してください。
   過度な実装ずれが起きた場合、接点部への半田上がりが発生する可能性があります。
   There are instruction of design the following. Please prepared without pattern area.
   When an excessive mounting gap occurs, there may be contact area solder wicking.

7. 実装性能（平坦度）は、実装基板の反りの影響を含まないものと致します。基板の反りはコネクタ両端部を基準とし、コネクタ中央部にて Max0.02mmとして下さい。
   The mounting specification for coplanarity does not include the influence of warpage of P.W. Board. The warpage of P.W. Board should be a maximum of 0.02mm if measuring from one connector edge to the other.

8. 本製品の一般性能確認はガラスエポキシ基板にて実施しております。フレキシブル基板等の
   特殊な基板へ実装する場合は、事前に実装確認等を行った上で使用願います。
   This connector performance was tested based on using rigid epoxy-glass P.W. Board. If you need to reflow the connector on FPC, please make sure to conduct the reflow test in advance.

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

9. フレキシブル基板に実装する場合は、基板の変形を防止するため、補強板のご使用をお勧めします。
本製品は低背のため、接点部への半田上がりが発生しないように、リフロー条件を設定して下さい。
Please apply capton when you mount the connector onto FFC/FPC to prevent deformation of FPC.
Due to the low profile design, please be cautious to set the reflow condition to prevent solder wicking

10. 実装条件（基板、メタルマスク、クリーム半田など）により、コネクタの実装状態（半田上がり）が異なることがあります。
Fillet condition might be different depending on the mounting condition, please care of fillet condition of connectors.

11. リフロー条件によっては、樹脂部に変色が発生する場合がありますが、製品性能に影響はありません。
There may be a case which changes housing color by depending on reflow conditions. However, it does not affect on connector performance.

12. リフロー条件によっては、端子めっき部よりヨリ等が発生する場合がありますが、製品性能に影響はありません。
There may be a case that the plating surface looks wavy by depending on reflow conditions. However, it does not affect on connector performance.

13. リフロー後、半田付け部に変色が見られることがありますが、製品性能に影響はありません。
また、製品仕様上、テール上面まで半田濡れ上がりはありませんが、製品性能上問題ありません。
There is no influence in the product performance though discoloration might be seen in the soldering tail after the reflow. There is no solders on the top surface of tail in spec, and there is no influence in performance.

14. 本製品は端子先端部にカット面がある為、端子先端部の実装性(基板への半田付け性)は端子側面・後側に比べて悪くなります。しかし、側面及び後側においてフィレットが形成されていれば、機能及び強度に問題はありません。
Because this product has a cutoff area on the tip of the terminal, the solderability performance in this area is not as good as compared to the side/back of the terminal. However, by building a good soldering fillet at the side/back of the terminal, there will be no issue on either the product function or the printed circuit board retention force.

15. 半田実装部の未半田は、ターミナル脱落、ピン間ショート、ターミナル座屈、またコネクタの基板からの外れが懸念されます。従って全てのターミナルテール部及び、ネイル部に半田付けを行って下さい。
If you leave any soldering area on this product open, there may be the possibility of a missing terminal short circuiting between pins, terminal buckling or the potential for the connector to come off of P.W. Board. Therefore, please solder all of the terminals and fitting nails P.W. Board.

16. 実装機によってコネクタに負荷が加わると変形、破損する場合がありますので事前にご確認下さい。
If there is accidental contact with the connector while it is going through the reflow machine, there may be deformation or damage caused to the connector. Please check to prevent this.

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

17. 実装後において手半田コテによるリペアーを行なう際は、必ず仕様書掲載の条件以内で行なって下さい。条件を超えて実施した場合、端子の抜け、接点ギャップの変化、モールドの変形、溶融等、破損の原因になります。
When conducting manual repairs using a soldering iron, please follow the soldering conditions shown in the product specification. If the conditions in the product spec are not followed, it may cause the terminals to fall off, a change in the contact gap, a deformation of the housing, melting of the housing, and damage the connector.

18. 半田こてによる手修正を行なう際、過度の半田やフラックスを使用しないで下さい。半田上がりやフラックス上がりにより接触、機能不良に至る場合があります。
When conducting manual repairs using a soldering iron, please do not use more solder and flux than needed. This may cause solder wicking and flux wicking issues, and it will eventually cause a contact defect and functional issues.

19. 基板実装後に、基板を直接積み重ねないように、注意してください。
Please do not stack P.W. Board directly after mounted the connector on it.

20. 本製品をSn-Ag-Cu系(重量比96.5%-3%-0.5%)以外の半田でご使用される場合は、事前に半田付け性、半田剥離強度などをご確認くださるようお願いします。
If an alternative solder past is used (other than Sn-Ag-Cu 96.5%-3%-0.5%), please ensure in advance that the solderability and P.W. Board peeling force will not have any issues.

21. 本製品をご使用時に取り付けられた電線・プリント基板の共振や、機器の回転構造や可動部分の動作によりコネクタ嵌合部(接点部)が常に動いてしまう状態での御使用は避けて下さい。接触部の摺動磨耗等による 接触不良の原因となります。 従って、機器内で電線・プリント基板を固定し、共振を抑える等の処置をお願い致します。
Please do not use the connector in a condition where the wire, P.W. Board, or the contact area is experiencing a sympathetic vibration of wires and P.W. Board, and constant movement of devices. This may cause a defect in the contact due to the contact area being worn down. Therefore, please fix wires and P.W. Board on the chassis, and reduces sympathetic vibration.

22. コネクタの性能を損なう恐れがある為、コネクタの洗浄は、行わないで下さい。
Please do not conduct any “washing process” on the connector because it may damage the product’s function.

23. 本リフロー条件に関しては、温度プロファイル、半田ペースト、大気、N2リフロー、基板などにより条件が異なりますので事前に実装評価(リフロー評価) を必ず実施願います。実装条件によっては、製品性能に影響を及ぼす場合があります。
Please investigate the mounting condition (reflow soldering condition) on your own devices beforehand. The mounting conditions may change due to the soldering temperature, soldering paste, air reflow machine, Nitrogen reflow machine, and the type of P.W. Board. The different mounting conditions may have an influence on the product’s performance.

24. コネクタのみで基板を支えることは避け、コネクタ以外での基板固定対策を行ってください。
Please do not use the connector alone to provide mechanical support for P.W. Board. Please ensure that there is a fixed structure on the phone chassis or other component support for P.W. Board

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

25. 一枚の基板にコネクタを複数実装する場合は、嵌合相手側はそれぞれ個別の基板に実装してご使用願います。
There should not be more than one board to board connection between two separate P.W. Board.
When mounting several board to board connectors between parallel P.W. Board, please ensure to separate each mated board to board connectors by using separate P.W. Board.

26. コネクタに外力が加わらないようにクリアランスをあけた筐体構造にして下さい。
Please keep enough clearance between connector and chassis of your application in order not to apply pressure on the connector.

27. 活電状態の電気回路で、挿入、抜去ができることを前提に作られていません。スパーク等による危険の発生、性能不良につながりますので、活電状態での挿入、抜去はしないで下さい。
This product is not designed for the mating and unmating of the connectors to be performed under the condition of an active electrical circuit. It may cause a spark and product defect if the connectors are mated and unmated in this way.

28. 嵌合後、コネクタピッチ方向、スパン方向及び回転方向への負荷がかかるような動作またはセットはしないでください。コネクタ破壊やはんだクラックを引き起こします。
After mated the connector, please do not allow P.W. Board to apply pressure on the connector in either the pitch direction or the span direction. It may cause damage to the connector and may crack the soldering.

29. 本製品は低背の為、REC端子ビーム部、及びPLUG端子コンタクト部裏面側面へのフラックス上がりが発生する事がありますが、製品性能には影響ありません。
Due to the low profile design, there might be the flux going up to receptacle terminal beam part and the other side of plug contacting part. However, it does not effect on connector performance.

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.	REV. RECORD	DATE	ECN NO.	WRITTEN BY :	CHECKED BY :
1	**PROPOSED**	**2015/01/27**	**J2015-******	**TSOMEYA**	**KTANAKA03**
0	**RELEASED**	**2015/02/23**	**J2015-0969**	**TSOMEYA**	**KTANAKA03**
A	**REVISED**	**2015/03/06**	**J2015-1134**	**TSOMEYA**	**KTANAKA03**
B	**REVISED**	**2015/04/24**	**J2015-1432**	**TSOMEYA**	**KTANAKA03**
C	**REVISED**	**2015/06/17**	**J2015-******	**TSOMEYA**	**KTANAKA03**
D	**REVISED**	**2015/07/07**	**J2016-0026**	**TSOMEYA**	**KTANAKA03**
E	**REVISED**	**2015/07/27**	**J2016-0086**	**KSASAKI**	**KTANAKA03**
F	**REVISED**	**2015/09/28**	**J2016-0319**	**TSOMEYA**	**KTANAKA03**
G	**REVISED**	**2015/10/13**	**J2016-0369**	**TSOMEYA**	**KTANAKA03**

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION